

躍上雲端的EDA設計力—加速產品上市的新契機

EDA on Cloud - A New Alternative to Speed Up Time-to-Market

講師陣容



台灣積體電路製造股份有限公司

姜安祺

台積電雲端聯盟負責人



台灣微軟

呂欣育

雲端平台解決方案 副總經理



益華電腦

宋栢安

台灣區總經理



富比庫股份有限公司

陳怡婷

執行長

隨著越來越多元的新興應用崛起，對於晶片的需求上升之外，更有體積縮小、效能提高同時也要兼顧節能等要求，使得晶片設計變得益趨複雜。在搶佔市場的壓力之下，如何加快開發流程，爭取上市時間變成了IC設計公司重要的課題之一。因應此問題，半導體產業鏈開始尋求「雲端」來解決問題。透過「雲」作為IC設計平台，運用雲端上的運算資源，可讓不同區域的團隊跨域合作，加快設計流程，節省產品開發時間，有助IC設計廠商加速產品上市時程。

為了使客戶更有效率的推出新產品，EDA公司開始與雲端服務業者合作，幫助IC設計廠商的設計流程更為順暢、有效率，進而加速科技發展的進程。SEMI電子系統設計產業聯盟（The Electronic System Design Alliance, ESD Alliance）將於3月13日舉辦主題為「躍上雲端的EDA設計力—加速產品上市的新契機（EDA on Cloud - A New Alternative to Speed Up Time-to-Market）」論壇，特邀請半導體龍頭大廠、軟體巨擘、一線EDA相關供應商等多位專家進行專題演講，歡迎晶圓製造、IC設計、EDA、IP智財等公司及學界菁英共襄盛舉，一起精確掌握躍上雲端的EDA世界。

活動資訊

■ 活動日期：2019年3月13日（三）9:00-11:40

■ 活動地點：新竹國賓大飯店 11樓 - 竹萱廳（新竹市中華路二段188號）

■ 報名資訊：每間公司限兩位免費名額，ESD Alliance會員公司享優先報名權。（主辦單位保留報名資格之最後審核權利。）

活動議程

時間	講題	演講者
09:00 - 09:30	報到	
09:30 - 09:35	歡迎致詞	Jo-ann Su / 蘇貞萍, SEMI / SEMI 國際半導體產業協會
09:35 - 10:00	「開放創新平台」上雲端 - 半導體設計的新時代	Vivian Jiang / 姜安祺, TSMC / 台灣積體電路製造股份有限公司
10:00 - 10:25	Azure for Silicon Development - 半導體設計與製造邁向雲端新世代	Andrew Lu / 呂欣育, Taiwan Microsoft / 台灣微軟
10:25 - 10:35	SEMI 暨電子系統設計產業聯盟簡介	SEMI / SEMI 國際半導體產業協會
10:35 - 10:50	交流時間	
10:50 - 11:15	雲端平台導入EDA工具	Brian Sung / 宋栢安, Cadence Taiwan / 益華電腦
11:15 - 11:40	雲端無人辦公室	YT Yi-Ting Chen / 陳怡婷, FootPrintKu / 富比庫股份有限公司

* 主辦單位保留變更議程與講師之權利

■ 聯繫窗口：SEMI 蘇先生 Chris Su Email: staiwan1@semi.org 電話：03-560-1777 #289

主辦單位：

共同主辦單位：

贊助商：



立即掃描
QR Code
線上報名

